

課題番号 : F-15-FA-0023
利用形態 : 機器利用
利用課題名(日本語) : リフトオフ用 Wf. の作製
Program Title (English) : Manufacture of Wf. for liftoff
利用者名(日本語) : 福田浩太, 古木勝義
Username (English) : K. Fukuda, K. Furuki
所属名(日本語) : 株式会社高田工業所
Affiliation (English) : TAKADA CORPORATION

1. 概要(Summary)

弊社では、半導体用枚葉式ウェット装置の製作を行って行おり、顧客へのPRの為にリフトオフ用 Wf. の作製をおこなった。

2. 実験(Experimental)

【利用した主な装置】

- ・マスクアライナー
- ・電気炉
- ・プラズマ CVD
- ・スピコーター
- ・スパッタ装置

【実験方法】

共同研究開発センターにて、4 インチ Si ウェハに電気炉、プラズマ CVD で Si 酸化膜を堆積した後、弊社ロゴをフォトリソグラフィによりパターンニングし、全面に Al 薄膜をスパッタ装置で成膜した。その後、弊社のリフトオフ装置にてリフトオフ実験を実施した。

3. 結果と考察(Results and Discussion)



Fig.1 Display Si wafer
(Left : before liftoff, Right : after liftoff)



Fig.2 extended photo of lift off wafer

4. その他・特記事項(Others)

なし。

5. 論文・学会発表(Publication/Presentation)

なし。

6. 関連特許(Patent)

なし。

【枚葉式ウェット装置の外観】

